




ABSTRACT OF THE DISCLOSURE

本発明の目的は、ダーフィルの不要なフリップチップ接続を可能とする半導体装置を実現することにある。

本発明は、半導体素子と、粒子を含有する絶縁材料を該半導体素子の上にマスク印刷することで形成された絶縁層と、該絶縁層の上に形成され該半導体素子の有する電極と電気的に接続した外部接続端子とを有するものである。